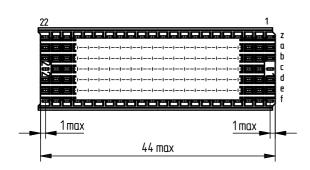
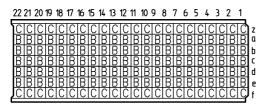


11.2 +0.2

Ebene - Level 3



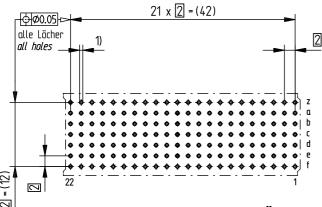
Bestückungsplan – contact layout



Ebene - Level 2 8.2 +0.2 Ebene - Level 1 4.5±0.3 3.7 ±0.3 P2 **1** P1 U1 Bezugsebene Tiefe 13 ±0.3 Datum plane depth R3 ₩ R2 1 R1 13 ±0.2 5.3 ±0.1 14.5 ±0.2 6.8 ±0.1 16 ±0.2 8.3 ±0.1

Lochbild für Leiterplatte (Bestückungsseite)

Board hole pattern (Component mounting side)



1) Ø 0,6±0.05 Durchmesser des metallisierten Loches Ø 0,6±0.05 Diameter of finished plated-through hole Ø 0,7±0.02 Bohrungsdurchmesser des Loches

Ø 0,7±0,02 Diameter of drilled hale

Schichtaufbau im metallisierten Loch siehe Zeichnung 114406 Metal plating of plated-through hole see drawing 114406

Fehlende Maße und Angaben nach IEC 61076-4-101 Missing information and dimensions per IEC 61076-4-101

Bedruckung siehe Zeichnung 401186 Marking see drawing 401186

## Bei Änderung Variante 123965 (auf Transportpalette) beachten!



## **Mouser Electronics**

**Authorized Distributor** 

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

**ERNI Electronics:** 

914796